公司代码:688469 公司简称:芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"相关的内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

报告期公司营业收入81.80亿元,实现25.67%的高速增长;全年毛利率5.51%,同比提升4.48个百分点;归母净利润同比大幅减亏38.17%,亏损收窄至-5.95亿元,盈利能力显著改善。

截至报告期末,公司尚未实现盈利。主要系报告期公司尚处于产线建设初步完成、市场拓展快速增长阶段,产品结构尚未完全优化,规模效益未完全体现。

基于当前强劲的市场需求增长趋势,产品结构的持续优化,碳化硅、模拟IC以及功率模块等高附加值业务占比提升,且随着时间推移设备折旧压力逐步降低,为公司盈利改善提供了核心动力。展望未来,公司将完成从芯片代工到系统级方案提供者的全面升级,实现对汽车、AI服务器、工控及高端消费等关键领域的全覆盖,成为赋能全球新能源与智能化产业的核心力量。

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度利润分配预案为不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以上利润分配预案已经公司董事会审议通过,尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	芯联集成	688469	中芯集成

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张毅	商娴婷
联系地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号
电话	0575-88421800	0575-88421800
传真	0575-88420899	0575-88420899
电子信箱	IR@unt-c.com	IR@unt-c.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要业务为提供系统代工,主要包含应用于车载、AI(人工智能)、工控、高端消费领域的功率(功率器件、功率IC、微控制器等)系统代工和信号链(MEMS传感器\执行器、模拟IC、信号接口等)系统代工。

1、功率系统代工方面

(1)功率器件

功率器件产品包含IGBT、MOSFET、SiC MOSFET芯片及模组,应用于车载、工控、消费、服务器电源等多个应用领域,电压平台覆盖12V-6500V。其中高压功率器件产品主要应用于车载主驱,OBC(车载充电机)、充电桩、风光储、制氢、电力、服务器电源、电机变频驱动等领域。

(2)功率IC和微控制器

功率驱动与控制产品从高电压、大电流和高密度三个维度,提供完整的系统代工服务。其中已成熟量产的0.18um BCD平台,能满足电机驱动等各类驱动、电源管理、接口和AFE(电池管理系统芯片)等终端产品的代工需求;集成单芯片工艺平台BCD 60V/120V+eflash已完成多个客户端的产品验证;第二代90纳米BCD 50V/60V/120V平台已开发完成,配合新能源汽车和工业4.0集成SoC方案,提供高可靠性和更具成本优势的工艺方案;55纳米MCU(嵌入式闪存工艺)平台开发完成,40纳米MCU工艺平台持续开发中。

2、信号链系统代工方面

MEMS等传感信号链产品包含硅麦克风、激光雷达中的微镜和光源VCSEL芯片、压力传感、惯性传感器等。其中应用于高端消费、新能源汽车的第三代麦克风进入量产,第四代麦克风通过初步验证进入产品迭代;车载和消费类多轴运动传感器规模量产;车载激光雷达VCSEL芯片大规模量产。

2.2 主要经营模式

由于模块化、集成化的市场需求快速凸显,公司在晶圆代工模式的基础上,持续敏锐捕捉市场需求迭代趋势。在横向维度上,打造了覆盖设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证、可靠性测试环节的一站式系统代工服务体系;在纵向维度上,逐步完成从功率器件、模拟IC、MCU到系统方案的全层级布局,构建起"功率-模拟IC-MCU-系统代工方案"的战略实现路径,全方位满足客户由点到面、从单一芯片到整体应用的全链条代工需求。

基于核心产品线优势,公司继续延伸拓展系统方案能力,形成汽车(包含电驱、电源、电池管理、底盘、热管理、灯、车身控制等)、AI数据中心(电源、光通信等)、工控、高端消费等的系统方案全覆盖能力。依托该模式,公司可为不同类型客户提供更高效、灵活、可靠的整体解决方案,通过深度嵌入客户产品开发全流程,实现各环节协同优化,助力客户提升产品可靠性与性能、降低综合成本、缩短产品上市周期,与客户构筑长期稳定的合作伙伴关系。

同时,公司持续优化升级经营策略,不断丰富一站式系统代工服务模式的内涵与外延,重点推进系统方案的研发与落地,进一步提升与客户合作方式的灵活性和多样性,强化全链条服务壁垒,持续增加客户合作黏性。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2025年在新能源汽车普及、智能驾驶渗透、AI算力需求爆发及新能源产业回暖等多重因素驱动下,全球半导体行业在周期性调整后实现强劲复苏。新能源汽车、AI(人工智能)、消费电子、风光储等细分领域需求旺盛,带动功率器件、模拟IC等核心产品保持较快增长。根据美国半导体行业协会(SIA)数据,2025年全球半导体销售额达7,917亿美元,同比增长25.6%。

中国作为全球最大的汽车、新能源及消费电子市场,其对半导体产品的需求正随着汽车电动化与智能化、人工智能产业等新兴领域的快速发展而持续增长。工信部数据显示,2025年中国集成电路产量达到4,843亿块,同比增长10.9%。海关总署数据显示,2025年中国集成电路出口额约为2,019亿美元,同比增长26.8%。

① 新能源汽车赛道需求持续增长,智能化有望加速落地

2025年,中国汽车行业受政策拉动需求有所提升,新能源车市场延续增长态势。根据中国汽车工业协会数据,2025年,中国汽车销量3,440.0万辆,同比增长9.4%,其中新能源汽车销量达1,649.0万辆,同比增长28.2%。乘用车方面,据统计,2025年中国乘用车销量3,010.3万辆,同比增长9.2%,其中新能源乘用车销量1,553.7万辆,新能源乘用车渗透率达51.6%。与此同时,随着智能驾驶数据资源积累,算力、大模型等AI技术的迭代升级,智能驾驶有望从量变到质变,智能化成为当前车企的重要发力点。

功率半导体作为汽车电子的核心,是新能源汽车中成本仅次于电池的第二大核心零部件。新能源汽车市场的持续增长和智能化技术的快速发展,将为功率半导体、模拟IC、传感器等半导体带来广阔增量机遇。

② AI算力驱动数据中心革新升级,第三代半导体和MicroLED迎来广阔发展空间

AI数据中心电源领域,大模型及AI应用的不断涌现和迭代,使得全球算力需求呈现增长态势,数据中心建设规模持续扩大、服务器数量增加,单台服务器机柜功耗不断上升。算力的尽头是电力,AI算力的扩张有望持续推动高功率、高效率和高稳定性的AI服务器电源需求增长,为上游功率、模拟及数模混合芯片产业带来了新的市场机遇。

与此同时,算力规模扩张带来的功耗与散热压力持续提升,对AI数据中心电源核心功率器件的性能提出了革命性要求。在此背景下,以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体功率器件,凭借其优异的高频、高压、低损耗特性,成为适配新一代AI算力基础设施的优选方案。未来随着AI算力基础设施不断升级,特别是AI数据中心800V/±400V高压直流架构(HVDC)持续演进、固态变压器(SST)逐步实现规模化应用,第三代半导体功率器件市场需求有望迎来快速放量与高速增长。

AI数据中心传输领域,随着人工智能算力需求快速增长,AI数据中心内部传输对更高带宽、更低时延和更高能效的要求日益提升,短距高速光通信技术迎来重要发展机遇。MicroLED光通信方案凭借高集成度、低功耗、高速传输等优势,已成为AI数据中心传输领域的重要新方向,并获得行业头部企业的支持。随着MicroLED光通信方案大规模导入市场及更高带宽方案逐步落地,其需求量有望大幅增长,预计2026-2027年将从实验室研发加速走向产业化应用。

③ 人形机器人产业化提速,核心器件迎发展新机遇

2025年,中国人形机器人在商业化落地进程中实现突破性进展,核心零部件国产化水平持续提升,量产能力与场景应用逐步成熟,在物流、工业等多个核心场景逐步实现规模化交付。据中国信通院数据,2025年全球人形机器人市场规模达170亿元,中国市场规模突破85亿元,占全球比重超50%。人形机器人从"实验室"走向"大规模商业化",为传感器、功率半导体及模拟IC等上游核心器件注入强劲增长动能。

④ 消费电子需求复苏趋势延续,AI(人工智能)赋能打开全新增长空间

当前全球智能手机、PC、家电行业延续需求回暖趋势。据Omidia数据,在3C电子领域,2025年全球智能手机出货量达到12.5亿部,同比增长1.8%,全球PC出货量2.8亿台,同比增长9.1%;受益于国补政策,2025年家电领域行业增长较好,根据国家统计局数据,2025年中国家用电器和音像器材类社会零售总额增长11.0%。与此同时,AI端侧应用正在加速,给手机/PC、可穿戴等硬件产品带来创新和新的机遇,2025年消费电子行业迎来上行周期。

终端产品的升级换代或将带动消费电子领域MEMS传感器芯片、功率器件及模拟IC等的整体增长,同时AI手机及AIPC搭载大模型带来大量计算、高能耗需求,带动电源管理类芯片形成新场景下的增量需求。

⑤ 风光储装机规模快速增长,政策助力新能源产业高质量发展

2025年,风光储行业在政策引导与市场需求的双重驱动下,整体保持持续向好的发展态势。国家能源局联合相关部委在报告期内密集出台《分布式光伏发电开发建设管理办法》《新型储能制造业高质量发展行动方案》等一系列新能源产业支持政策,推动新能源产业由规模化扩张向高质量发展阶段加速转型,为我国新能源产业提质增效、迈向高质量快速发展新阶段提供了坚实的政策保障与有力支撑。

根据国家能源局统计,风电领域,2025年中国风电装机6.4亿千瓦,同比增长22.9%,海上风电进入建设大年;光伏领域,分布式光伏新政推动光伏"抢装",2025年中国太阳能发电装机容量12.0亿千瓦,同比增长35.4%;储能领域,据CESA统计,2025年中国新型储能新增装机规模达196.5GWh,同比增长79.3%(容量);中国企业同步加快国际化步伐,特别是2025年下半年订单迎来集中爆发,根据CNESA Data Link不完全统计,2025年中国储能企业新增海外订单规模366GWh,同比增长144%。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

芯联集成致力于成为一站式系统代工解决方案的领导者。

在晶圆代工方面,据Chip Insights数据,公司已迈入晶圆代工"第一梯队",跻身全球专属晶圆代工榜单前十,中国大陆第四。

(1)功率器件领域,公司是中国最大的车规级IGBT生产基地之一,同时公司在SiC MOSFET出货量上稳居亚洲前列,是国内产业中率先突破主驱用SiC MOSFET产品的头部企业,2025年公司8英寸碳化硅已经实现量产出货;

(2)模拟IC领域,公司持续开发国内独有、稀缺的高压BCD平台,是国内在该领域布局最完整的企业之一,公司的BCD工艺技术研发已达到国际领先水平,且多个新平台已实现规模量产;

(3)MEMS领域,公司是国内规模最大、技术最先进的MEMS晶圆代工厂;根据Yole发布的《MEMS产业现状2025》,芯联集成位列全球MEMS晶圆代工厂第五名,是中国大陆唯一进入全球前五的MEMS代工企业。

在模组封装方面,公司的功率模块出货量位居中国市场前列。

根据NE时代统计,2025年公司在国内乘用车功率模块装机量排行榜位列第四。

目前公司SiC MOSFET芯片及模组已全面覆盖650-3300V碳化硅工艺平台,产品关键指标均处于国内领先水平。根据Yole发布的2025年碳化硅(SiC)业务排名,公司是中国SiC器件厂商中位居第一的企业。2025年公司碳化硅业务实现同比快速增长,跻身全球前五,并占据约5%的全球市场份额。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

新能源汽车产业深度变革、人工智能技术全面演进、AI算力规模化爆发与AI应用加速推进,共同催生新技术、新业态、新模式,为经济发展注入新的增长动力。

全球汽车产业持续迈向电动化、智能化、低碳化深水区,产业生态由链式协同,网状协作,向跨领域、全方位深度融合加速演进,新能源汽车与能源网、交通网、算力网深度耦合,推动车-路-云一体化协同创新;技术方面,8英寸碳化硅工艺平台规模化量产、氮化镓车载电源加速导入,有效提升电驱效率与续航可靠性,物理级AI与智能驾驶深度融合,推动车规级电源管理、传感、驱动芯片向高集成、高可靠、高能效方向迭代;新业态方面,产业链协同持续深化,芯片制造、封测与应用方案加速融合,整车与供应链从单一器件采购转向系统化、一体化解决方案合作;未来,AI(人工智能)全面应用将持续拉高车载算力需求,第三代半导体成为主流技术路线,为公司带来广阔发展机遇。

2025年AI算力需求进入规模化爆发阶段,智算基础设施进入集中升级阶段,能源供给与数据传输成为支撑算力高效运转的两大关键方向。AI数据中心供配电体系持续向高压化、高效化、模块化方向演进,高可靠、大功率供电方案需求快速提升,电源系统架构持续迭代升级。碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料凭借低损耗、高效率的优势,显著提升系统能效与运行稳定性,有力推动功率器件及上游芯片产业创新发展。与此同时,算力互联不断向高速率、低时延、高集成度方向升级,光通信成为破解高带宽传输瓶颈的重要技术路线。MicroLED凭借优异的集成度、低功耗与高速传输特性,逐步由前沿研发迈向产业化预备阶段,为数据中心高速传输领域开辟出新的发展空间。

高端消费领域迎来AI硬件深度普及的新阶段,人工智能由云端向终端全面渗透,智能穿戴、空间交互设备、智能交互玩具等新兴产品快速兴起。终端向轻量化、随身化、沉浸式交互升级,多模态感知、自主交互成为行业重要发展方向。同时具身智能相关产品逐步融入高端消费场景,推动终端形态进一步丰富。技术迭代不断催生新业态、新模式,有力拉动功率、模拟IC、传感器、MCU等核心芯片需求增长,为相关产业带来广阔的发展空间与持续增长动力。

报告期内,基于客户需求,公司系统方案能力正加速构筑与落地。公司持续优化和提升经营策略,不断丰富和升级经营模式,进一步提升公司与客户之间合作方式的灵活性和多样性,增强公司与客户合作的黏性。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	33,180,986,285.55	34,202,723,841.88	-2.99	31,570,366,445.66
归属于上市公司股东的净资产	13,034,362,112.63	12,321,013,873.28	5.79	12,483,074,709.70
营业收入	8,179,732,880.37	6,509,090,845.76	25.67	5,324,482,794.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	7,889,401,345.88	6,276,082,906.15	25.71	4,910,739,546.44
利润总额	-1,932,576,414.36	-2,246,503,325.61	减亏13.97%	-2,941,428,756.44
归属于上市公司股东的净利润	-594,893,008.06	-962,159,563.25	减亏38.17%	-1,958,331,781.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,118,722,560.11	-1,409,560,221.69	减亏20.63%	-2,261,685,779.13
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	2,177,565,829.97	2,145,713,627.83	1.48	925,416,752.03
经营活动产生的现金流量净额	2,134,608,728.19	1,902,620,390.86	12.19	2,614,301,648.62
毛利率(%)	5.51	1.03	增加4.48个百分点	-6.81
净利率(%)	-23.63	-34.51	不适用	-55.24
息税折旧摊销前利润率(%)	26.62	32.96	减少6.34个百分点	17.38
加权平均净资产收益率(%)	-4.95	-7.97	增加3.02个百分点	-22.44
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.14	不适用	-0.32
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.14	不适用	-0.32
研发投入占营业收入的比例(%)	23.76	28.30	减少4.54个百分点	28.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,733,684,310.68	1,761,513,459.49	1,926,756,627.44	2,757,778,482.76
归属于上市公司股东的净利润	-182,289,864.64	11,949,489.86	-292,707,251.85	-131,845,381.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-230,213,235.19	-305,394,892.10	-337,641,244.12	-245,473,188.70
经营活动产生的现金流量净额	171,757,565.56	809,667,569.76	-209,109,538.60	1,362,293,131.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	128,003
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	128,726

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)		1,152,000,000	13.74	1,152,000,000	无		境内非国有法人
中芯国际控股有限公司		993,600,000	11.85	993,600,000	无		境内非国有法人
绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	454,009,900	454,009,900	5.42	454,009,900	无		境内非国有法人
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)		230,400,000	2.75	230,400,000	无		境内非国有法人
绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)		216,000,000	2.58	216,000,000	质押	190,000,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-22,524,011	196,249,363	2.34		无		其他
香港中央结算有限公司	172,720,643	192,668,633	2.3		无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,105,887	183,361,707	2.19		无		其他
深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	181,603,960	181,603,960	2.17	181,603,960	无		境内非国有法人
厦门辰途华辉创业投资合伙企业(有限合伙)	139,229,702	139,229,702	1.66	139,229,702	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、滨海芯兴与越城基金存在关联关系;2、硅芯锐、日芯锐存在关联关系;除了上述股东关联关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
芯联集成电路制造股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25芯联集成SCP001(科创债)	012582609	2026-07-27	500,000,000	1.6

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

受评对象	评级机构名称	评级调整时间	评级级别变化	评级展望变化	评级结果变化的原因
芯联集成电路制造股份有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2025年7月30日	AAA	稳定	新增

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	44.69	41.68	3.01
扣除非经常性损益后净利润	-11.19	-14.10	减亏20.63%
EBITDA全部债务比	19.40	21.03	-1.63
利息保障倍数	-7.22	-5.34	不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入81.80亿元,较上年同期增长25.67%,其中主营业务收入增幅25.71%,保持了良好的增长势头。归属于上市公司股东的净利润为-5.95亿元,实现同比大幅减亏38.17%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2026-012

芯联集成电路制造股份有限公司关于核心技术人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")基于长期战略发展规划,结合研发人员工作内容变动与公司研发工作实际推进需求,对核心技术人员构成进行调整:原核心技术人员单伟中先生不再纳入核心技术人员认定范围,调整后将在公司相应适配岗位任职。

● 本次核心技术人员的调整已完成相关合规审查,不涉及专利权属纠纷或潜在争议,公司核心技术及知识产权权属保持完整,不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

一、核心技术人员调整的具体情况

公司基于长期战略发展规划,综合考量研发人员工作调整、岗位职能优化与公司研发工作实际推进需求等多重因素,经审慎评估后对核心技术人员构成进行调整。原核心技术人员单伟中先生因工作分工调整及岗位职能变化,不再被认定为核心技术人员,仍在公司担任相应适配岗位,履行岗位职责。

原核心技术人员的具体情况如下:

1、原核心技术人员简介

单伟中,男,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2002年至2018年,曾任中芯国际薄膜工艺资深经理、工艺整合资深经理。2018年至今,任公司执行总监。

截至本公告披露日,单伟中先生直接持有公司股份240,000股,持股比例为0.0029%,通过员工持股平台间接持有公司股份8,015,040股。单伟中先生不再被认定为核心技术人员后,将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

2、知识产权情况

单伟中先生作为核心技术人员期间参与研究并申请的专利均为职务成果,相应的知识产权归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形,也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

公司与单伟中先生签署了《保密协议》及《竞业限制协议》,对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定,双方明确约定了保密内容和违约责任。单伟中先生对其知悉公司的商业秘密(包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等)负有保密义务。截至本公告披露日,公司未发现单伟中先生有违反相关协议的情形。

二、核心技术人员调整对公司的影响

公司高度重视研发工作和人才梯队的建设,研发人员结构完善且合理,研发团队经验丰富,运行有效,已构建起体系化、科学化的研发管理体系,培养了一支兼具专业素养、奋斗精神与创新能力的研发团队。团队内部分工明确、协作高效,核心技术研发以集体攻坚为核心模式,不存在对单一核心技术人员的依赖。

截至2023年末、2024年末、2025年末,公司研发人员数量分别为662人、943人、1,226人,占员工总人数的比例分别为15%、19%、21%,研发人员数量呈增长趋势。研发团队结构稳定、专业配置均衡。本次调整后,公司核心技术人员团队仍保持充足的技术储备与研发能力,现有研发团队及核心技术人员能够完全支撑公司未来核心技术的持续迭代与创新产品的研发推进。本次核心技术人员调整是公司根据战略发展与岗位适配性作出的举措,以确保研发团队的建设与公司的研发方向相匹配,不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响,公司技术研发与日常经营活动均正常有序进行。

截至本公告披露日,公司核心技术人员变动情况如下表所示:

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	赵奇、刘煊杰、肖方、单伟中
本次变动后	赵奇、刘煊杰、肖方

三、公司采取的措施

截至本公告披露日,公司技术研发工作稳步推进,日常经营秩序井然,研发团队结构完整、后备人才储备充足,现有研发力量能够充分保障核心技术的持续创新与产品的迭代升级。为进一步强化技术研发实力与人才梯队建设,后续公司将采取以下措施:

1、加大专业技术人才引进力度,聚焦核心技术领域,精准吸纳行业内高端人才与优秀青年人才,持续优化研发团队结构;

2、完善内部人才培养体系,搭建技术培训、项目实践、职业晋升相结合的成长通道,加速后备技术人才培育;

3、优化研发人员考核与激励机制,将研发成果、技术贡献与薪酬回报、股权激励等深度绑定,充分激发研发人员的创新积极性与主动性;

4、持续加强知识产权保护体系建设,完善专利申请、维护、运用等全流程管理,确保公司核心技术与知识产权的安全性、完整性。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2026-011

芯联集成电路制造股份有限公司关于2026年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 套期保值(合约类别:商品;外汇;□其他:________) □其他:________	
交易品种	商品期货套期保值业务品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料,包括但不限于黄金、白银、钯、铂、铜等期货品种;外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	20,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	150,000
资金来源	自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	自董事会审议通过之日至2026年年度董事会召开之日止	

● 已履行及拟履行的审议程序

芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司"或"芯联集成")于2026年4月17日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2026年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的议案》,本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展的商品期货套期保值和外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,有利于稳定公司的正常生产经营,但商品期货套期保值和外汇衍生品业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险等,敬请投资者理性投资、注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及子公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对生产经营成本的影响,充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,不进行投机交易,有利于提升公司整体防御风险能力,增强财务稳健性。

公司及子公司开展外汇衍生品业务主要为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇使用效率,合理降低财务费用,公司拟根据具体业务情况,通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行,能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力,增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务主要用于支付海外供应商的采购款项,并将合理安排资金使用,不会影响公司主营业务的发展。

(二)交易金额

公司及子公司拟进行商品期货套期保值业务及外汇衍生品业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过2亿元人民币或等值外币。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币或等值外币,在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

为公司自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

(四)交易方式

公司开展商品期货套期保值交易品种仅限于公司及子公司生产经营相关的原材料,包括但不限于黄金、白银、钯、铂、铜等期货品种,交易工具优先选择标准期货合约,具体将结合交易品种的特点和公司经营需求的实际情况而确定。

公司开展外汇套期保值主要与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,交易品种主要为外汇汇率和外汇利率,包括但不限于日元、美元、欧元等币种。主要通过外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务进行。

(五)交易期限

自董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止。

二、审议程序

公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2026年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的议案》,本议案无需提交股东会审议。本次开展商品期货套期保值及外汇衍生品业务不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

(一)商品期货套期保值业务交易风险分析

公司商品期货套期保值业务,不做投机性、套利性的交易操作,可以部分规避价格风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能存在一定风险:

1、市场风险:市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃,可能产生价格波动风险,造成套期保值损失。

2、资金风险:部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度,可能会给公司带来一定的资金流动性风险。期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令,在持有市场反向头寸较大,且期货市场价格出现大幅变化时,公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。

3、操作风险:由于套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会存在因操作失误或流程不完善造成错单,给公司带来损失。

4、系统风险:全球性经济影响导致金融系统风险。

5、信用风险:当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失,或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。

(二)外汇衍生品业务交易风险分析

公司开展外汇衍生品业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但仍存在一定的风险:

1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险:不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割外汇衍生品,可保证在交割时拥有足额资金供清算,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险:不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。

4、其他风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(三)风险防控措施

1、遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,不做投机性交易。

2、公司已制定严格的《套期保值业务管理制度》,对整个套期保值的操作原则、风险处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4、公司内部审计部门负责定期对衍生品交易情况进行审查和评估。

5、严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查,按相关规则要求适时履行信息披露义务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展商品期货和外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下,为提高应对材料价格及汇率波动风险的能力,降低材料价格及汇率大幅波动对公司经营业绩的影响而采取的措施。该事项相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于增强公司财务稳健性,控制经营风险,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

公司基于成本效益考量,为降低会计处理的复杂性与成本,对开展的套期保值业务将采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行简化处理,不适用《企业会计准则第24号——套期会计》的相关规定。具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司开展套期保值业务旨在降低原材料价格波动对公司生产经营的影响,以及防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响,增强公司财务稳健性。公司已针对套期保值业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施。公司开展套期保值业务的事项履行了必要的审批程序,决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

综上,保荐机构对公司开展套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码:603196 证券简称:璞源材料 公告编号:2026-031

上海璞源化学材料集团股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年04月28日(星期二)11:00-12:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月21日(星期二)至04月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@porigine.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海璞源化学材料集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年4月28日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年04月28日(星期二)11:00-12:00举行2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2026年04月28日(星期二)11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:梁丰

总经理:吕超

独立董事:张其秀

财务总监:张云菊

董事会秘书:赵月波

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年04月28日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年04月21日(星期二)至04月27日(星期一)前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@porigine.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:021-80104103

邮箱:ir@porigine.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海璞源化学材料集团股份有限公司

2026年4月21日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-034

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年4月20日

(二) 股东会召开的地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	287
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	473,912,419
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.3702

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长闫久江先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人;

2、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	473,228,019	99.8556	536,400	0.1132	148,000	0.0312

2、议案名称:关于制定《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	471,935,219	99.5828	1,864,600	0.3934	112,600	0.0238

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于制定《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	6,519,919	76.7309	1,864,600	21.9439	112,600	1.3252

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市兰台律师事务所

律师:张步勇、王婷

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2026-006

浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 赎回理财产品名称:对公客户人民币大额存单。

● 本次赎回金额:人民币2,000万元

● 已履行的审议程序:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币8,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。自第三届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容见公司2025年4月29日披露的《浙江自然关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-024)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司以部分闲置募集资金人民币2,000万元由前手转入中国农业银行股份有限公司天台县支行的对公客户人民币大额存单,具体内容详见公司2025年5月6日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的公告《浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-029)。公司于近日提前赎回上述理财产品,收回本金2,000万元,获得理财收益45.825万元。

本次赎回产品的基本信息如下:

产品名称	产品类型	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
对公客户人民币大额存单	银行理财产品	中国农业银行股份有限公司天台县支行	2,000	2024/1/4	2027/1/4	2.35	2,000	45.825

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	普通大额存单	5,000	5,000	109.116667	0
2	普通大额存单	3,000	1,000	2.798611	2,000
合计		8,000	6,000	111.915278	2,000
最近12个月内单日最高投入金额				5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.46	
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)				0.60	
目前已使用的现金管理额度				2,000	
尚未使用的现金管理额度				6,500	
总现金管理额度				8,500	

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2026年4月21日

证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2026-014

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称"国联民生")出具的《关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司变更持续督导保荐代表人的函》具体情况如下:

作为公司首次公开发行股票的保荐机构,国联民生原指定王璐先生、陈卓先生为公司首次公开发行股票项目的保荐代表人,负责保荐工作及持续督导工作,持续督导期至2025年12月31日。持续督导期已于2025年12月31日届满,但截至目前,公司募集资金尚未使用完毕,根据相关规定,国联民生对此未尽事项继续履行持续督导义务。由于原保荐代表人王璐先生、陈卓先生工作变动,不再继续担任公司持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的有序进行,国联民生现委派王嘉麟先生、阙绪兴先生接替王璐先生、陈卓先生担任公司持续督导工作的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司持续督导的保荐代表人为王嘉麟先生和阙绪兴先生,继续履行相关的职责和义务,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对王璐先生、陈卓先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件

简历

王嘉麟先生,保荐代表人,现任国联民生证券承销保荐有限公司投资银行事业部业务副总裁,硕士研究生。王嘉麟先生曾参与康华生物(300841)首次公开发行股票并在创业板上市项目、森鹰窗业(301227)首次公开发行股票并在创业板上市项目、中鼎股份(000887)公开发行可转换公司债券项目、创业黑马(300688)发行股份及支付现金购买资产项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

阙绪兴先生,保荐代表人,硕士研究生学历,现任职于国联民生证券承销保荐有限公司投资银行事业部,曾参与近岸蛋白(688137)首次公开发行股票并在科创板上市项目、万邦医药(301520)首次公开发行股票并在创业板上市项目、德必集团(300947)首次公开发行股票并在创业板上市项目、信宇人(688573)首次公开发行股票并在科创板上市项目、数据堂IPO、力捷迅IPO、浩明科技IPO、罗莱迪思IPO、阳谷华泰(300121)可转债、创业黑马(300688)发行股份及支付现金购买资产等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。